

●SOP-8FD パッケージ許容損失

SOP-8FD パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

測定条件: 基板実装状態

雰囲気: 自然対流

実装: Pb フリーはんだ

実装基板: 基板 40mm × 40mm (片面 1600mm²) に対して

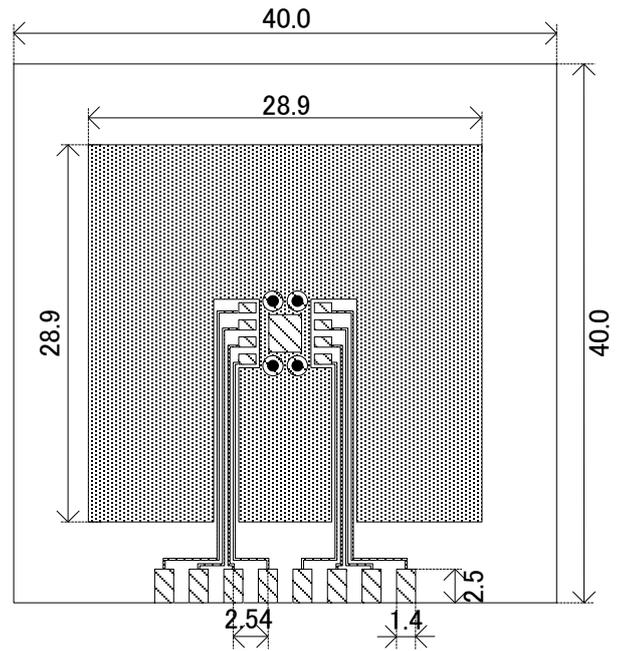
銅箔面積 表面 約 50%-裏面 約 50%

放熱板と周りの銅箔接続

基板材質: ガラスエポキシ (FR-4)

板厚: 1.6mm

スルーホール: ホール径 0.8mm 4個

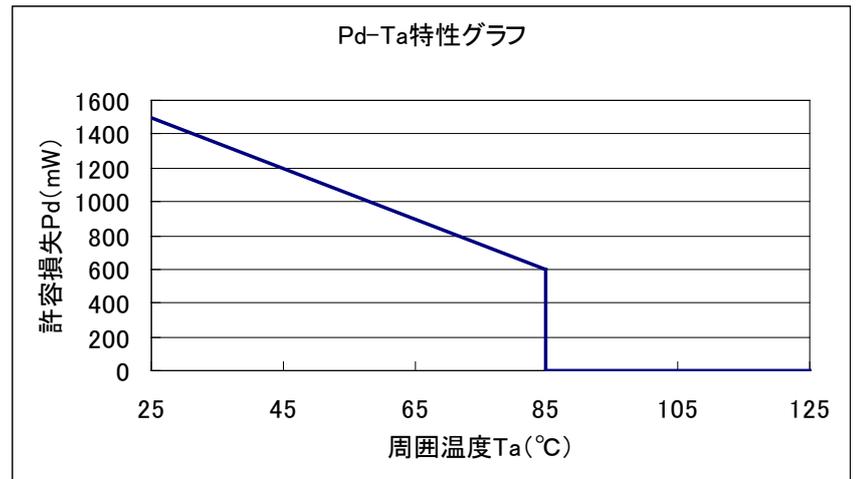


評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性(85°C保証品)

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}\text{C}$)

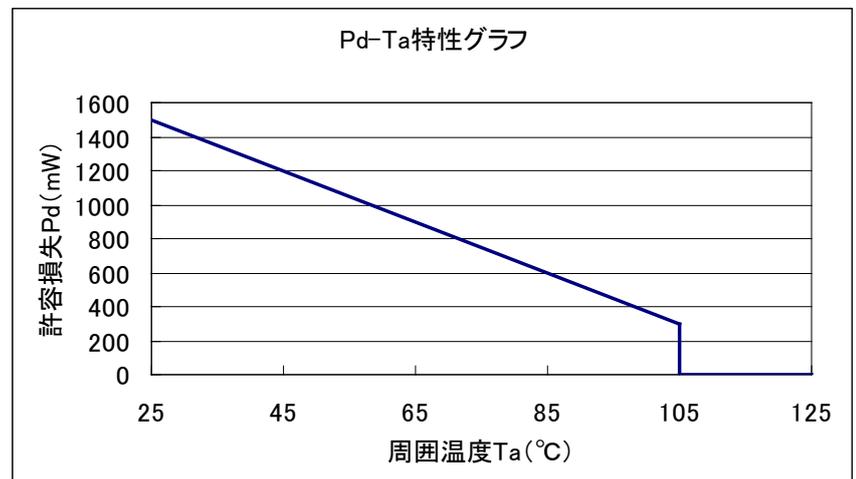
周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	1500	66.67
85	600	



3. 許容損失-周囲温度特性(105°C保証品)

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	1500	66.67
105	300	



●SOP-8FD パッケージ許容損失(JESD51-7)

SOP-8FD パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

測定条件: 基板実装状態

雰囲気: 自然対流

実装: Pb フリーはんだ

実装基板: 4層基板 76.2mm×114.3mm(片面約 8700mm²)

に対して銅箔面積

1層目: 銅箔無し

2層目: 70mm×70mm_放熱板と接続有

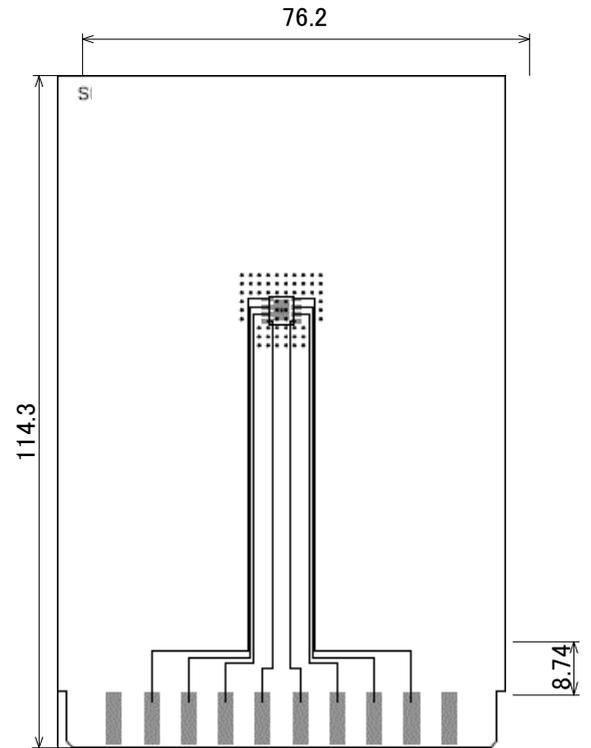
3層目: 70mm×70mm_放熱板と接続有

4層目: 銅箔無し

基板材質: ガラスエポキシ(FR-4)

板厚: 1.6mm

スルーホール: $\phi 0.2\text{mm}$ 60個



評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	$\theta_a(^{\circ}\text{C}/\text{W})$
25	2500	40.00
105	500	

